

单一来源采购方式专业人

姓名:

刘成

专业信息

职称:

高级工程师

工作单位:

部队

项目名称:

2016 芯片加工

项目信息

供应商名称:

西安紫光国芯半导体股份有限公司

512 年度采购计划

采购内容: 芯片加工

采购数量: 10000 片

采购金额: 100000 元

采购日期: 2016 年 12 月

采购地点: 西安

采购方式: 单一来源

采购理由: 芯片加工

采购结果: 成交

成交金额: 100000 元

成交日期: 2016 年 12 月

成交地点: 西安

成交方式: 单一来源

成交理由: 芯片加工

成交结果: 成交

成交金额: 100000 元

成交日期: 2016 年 12 月

成交地点: 西安

成交方式: 单一来源

成交理由: 芯片加工

成交结果: 成交

成交金额: 100000 元

成交日期: 2016 年 12 月

山西源泰物资集团专业员工资质证书

姓名:

张永强

专业信息

职称:

高级工程师

工作单位:

山西源泰物资集团

项目信息

项目名称:

山西源泰物资集团

供货名称:

山西源泰物资集团

Handwritten notes in various colors (green, red, blue) covering the bottom half of the page, including the name '张永强' and other illegible text.

单一来源采购方式专业人员论证意见书

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 专业人员信息          | 姓名: 梁向水        |
|                 | 职称: 教授         |
|                 | 工作单位: 北京航空航天大学 |
| 项目名称: 3DIC 芯片加工 |                |

合同信息

合同名称: 北京航空航天大学采购合同

论证意见: 该供应商具备履行合同所必需的设备、专业技术人员和售后服务能力, 且报价合理, 符合单一来源采购方式的条件。同意采用单一来源采购方式。

专业人员签字

梁向水

日期: 2024年11月07日

单一来源采购方式专业人员论证意见

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 姓名: 孔令华  |                            |
| 专业人员信息   | 职称: 教授                     |
| 工作单位: 苏州大学   |                            |
| 项目名称: 3DIC 芯片加工  |                            |
| 项目信息   | 单一来源采购方式论证报告编委: 紫光显示技术有限公司 |
| 本人声明: 本人作为单一来源采购方式论证专家, 对单一来源采购方式论证报告编制过程进行了认真审核, 认为该报告编制过程符合单一来源采购方式论证相关规定, 论证结论客观、公正、合理, 同意单一来源采购方式论证结论。 |                            |
| 本人承诺: 本人作为单一来源采购方式论证专家, 在论证过程中, 严格遵守相关法律法规, 恪守职业道德, 保持客观、公正、廉洁, 不徇私情, 不弄虚作假, 不泄露商业秘密, 不从事任何损害采购人利益的行为。     |                            |
| 专业人员   | 论证意见                       |
| 论证意见: 单一来源采购方式论证报告编制过程符合单一来源采购方式论证相关规定, 论证结论客观、公正、合理, 同意单一来源采购方式论证结论。                                      |                            |
| 论证日期: 2024年11月03日  |                            |
| 论证地点: 紫光显示技术有限公司   |                            |

姓名: 王超

专业人员信息

职称: 高级工程师

工作单位: 河南拓尔微电子股份有限公司

项目名称: 3DIC 芯片加工

项目编号: 2023-01

承担单位名称: 河南拓尔微电子股份有限公司

项目负责人: 王超

项目简介: 本项目旨在开发一种新型的3DIC芯片加工技术, 提高芯片的集成度和性能。项目团队由王超高级工程师负责, 团队成员包括多名研发人员和工艺工程师。项目计划于2023年10月启动, 预计于2024年6月完成。项目的主要目标是实现3DIC芯片的批量生产, 并达到国际先进水平。项目经费总额为1000万元, 其中自筹资金500万元, 政府补助500万元。项目进展顺利, 目前已完成芯片设计、工艺开发和试生产等工作。项目成果将广泛应用于通信、消费电子和工业控制等领域, 对提升我国芯片制造水平具有重要意义。